

113 年經濟部 晶創方案(產業補助)
產業技術司「IC 設計攻頂補助計畫」核定清單

公司名稱	計畫名稱	核定補助款(千元)	核定自籌款(千元)	核定總經費(千元)	核定年月
聯發科技股份有限公司	次世代行動通訊與先進人工智慧晶片設計技術開發計畫	2,500,000	10,000,000	12,500,000	113年9月
乾瞻科技股份有限公司	小晶片之間的裸晶互連與序列匯流排IP設計開發計畫	28,200	47,000	75,200	113年9月
瑞昱半導體股份有限公司	整合AI GPT之新一代高速800G DPU加速器晶片開發計畫	1,134,000	1,890,000	3,024,000	113年9月
群聯電子股份有限公司	新世代人工智慧應用落地6nm AI SSD儲存控制晶片開發計畫	180,000	300,000	480,000	113年9月
創鑫智慧股份有限公司	生成式AI推論加速晶片開發計畫	300,000	700,000	1,000,000	113年9月
昇佳電子股份有限公司(主導)、 連騰科技股份有限公司、 阿比特電子科技股份有限公司	高穩定IMU異質整合感測晶片與低功耗AI-AHRS晶片模組應用於無人載具開發計畫	132,000	252,000	384,000	113年9月
聯詠科技股份有限公司	裝置端AIGC之高效能運算晶片開發與實現計畫	407,000	777,000	1,184,000	113年9月
華邦電子股份有限公司	3D CUBE創新服務應用平台研發計畫	555,500	1,060,500	1,616,000	113年9月
慧榮科技股份有限公司	先進5nm PCIe Gen6資料中心儲存控制SoC研發計畫	425,000	935,000	1,360,000	113年9月
円星科技股份有限公司	每秒400億位元低功耗3奈米行動產業處理器界面C/D組合式實體層(C/D Combo PHY) 發射器/接收器矽智財計畫	28,000	61,600	89,600	113年9月
茂德科技股份有限公司(主導)、 世界先進積體電路股份有限公司、 上詮光纖通信股份有限公司	超高速200Gb/λ矽光晶片設計、製造及封測技術開發計畫	70,000	154,000	224,000	113年9月